



中华人民共和国国家标准

GB/T 38273.2—2019

塑料 热塑性聚酯/酯和聚醚/酯 模塑和挤塑弹性体 第2部分：试样制备和性能测定

Plastics—Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester
elastomers for moulding and extrusion—
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

(ISO 20029-2:2017, MOD)

2019-12-10 发布

2020-11-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

GB/T 38273《塑料 热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑弹性体》分为两个部分：

——第 1 部分：命名系统和分类基础；

——第 2 部分：试样制备和性能测定。

本部分为 GB/T 38273 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用重新起草法修改采用 ISO 20029-2:2017《塑料 热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑弹性体 第 2 部分：试样制备和性能测定》。

本部分与 ISO 20029-2:2017 相比存在技术性差异，附录 A 中列出了本部分与 ISO 20029-2:2017 技术性差异及其原因一览表。

本部分做了下列编辑性修改：

——删除范围中的最后一段。

本部分由中国石油和化学工业联合会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 15)归口。

本部分起草单位：金发科技股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、江苏钟山化工有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。

本部分主要起草人：黄险波、袁绍彦、杨莉、吴亚清、郑雯、史淑慧、赵巍、李光磊、王建东。

塑料 热塑性聚酯/酯和聚醚/酯 模塑和挤塑弹性体

第2部分:试样制备和性能测定

1 范围

GB/T 38273 的本部分规定了热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑材料的试样制备和性能测试方法,以及试样处理、试样模塑前和试样测试前状态调节的要求。

本部分规定了热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑材料试样制备过程和条件以及这些试样测试材料性能的方法。同时也列出了表征热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑材料所需的性能及其测试方法。

性能项目选自 GB/T 19467.1 中的通用测试方法。本部分还包括热塑性聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑材料的其他一些特别重要的或广泛使用的测试方法,如 GB/T 38273.1 规定的特征性能(硬度、熔点和拉伸/弯曲模量)。

本部分适用于所有热塑性聚酯/酯和聚醚/酯弹性体。也适用于以粉状、颗粒状或片状等形态直接使用的和由着色剂、添加剂、填料等改性或者未改性的材料。

为了获得可比的及有重现性的测试结果,需按照本部分所规定的样件制备过程及状态调整方法、试样尺寸和测试方法进行。采用不同试样尺寸或样件制备方法的测试数据未必会一致。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法(GB/T 1033.1—2008,ISO 1183-1:2004,IDT)

GB/T 1033.2 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分:密度梯度柱法(GB/T 1033.2—2010,ISO 1183-2:2004,MOD)

GB/T 1033.3 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第3部分:气体比重瓶法(GB/T 1033.3—2010,ISO 1183-3:1999,IDT)

GB/T 1034 塑料 吸水性的测定(GB/T 1034—2008,ISO 62:2008,IDT)

GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(GB/T 1040.2—2006,ISO 527-2:1993,IDT)

GB/T 1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验(GB/T 1043.1—2008,ISO 179-1:2000,IDT)

GB/T 1043.2 塑料 简支梁冲击性能的测定 第2部分:仪器化冲击试验(GB/T 1043.2—2018,ISO 179-2:1997,IDT)

GB/T 1408.1 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(GB/T 1408.1—2016,IEC 60243-1:2013,IDT)

GB/T 1409 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数